頎邦科技股份有限公司實習生需求表 (一學年)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱 | 頎邦科技股份有限公司 | | | | |
| 負責人 | 吳非艱 | | 員工人數 | 約4,750人 | |
| 聯絡人 | 余珮吟 | | 職稱 | 正管理師 | |
| 聯絡電話 | 03-5678788 #2316 | | E-mail | mandyy@chipbond.com.tw | |
| 公司地址 | 新竹市力行五路三號(新竹科學園區) | | | | |
| 公司簡介 | 頎邦科技成立於1997年7月，為利基型的半導體封裝與測試服務供應商，主要業務為提供顯示器驅動IC後段封裝及測試代工服務，其中驅動IC封裝包括前段之金凸塊製程與後段之TCP及COG封裝，及覆晶封裝並包括前段之錫鉛凸塊製作。  頎邦科技原在金凸塊的產能位居全球第一大，於2010年4月與飛信進行合併，合併後，包括Wafer test、COF、COG的產能由第二名躍升為全球第一大，成為全球第一大驅動IC封裝公司！  我們提供實習生最直接的生產技術訓練，並規劃職涯發展的各項訓練與途徑，讓你在實習階段發覺自己所長，進而結合興趣與專業，持續學習與成長！本公司提供實習生各項福利如下。歡迎你主動爭取實習機會！ | | | | |
| 實習期間 | 2016年07月01日 至 2017年06月30日 | | | | |
| 實習工作內容 | | 名額 | 需求條件或專長 | | 是否面談 |
| 生產技術人員  -機台操作  -利用工具顯微鏡找出產品異常 | | 50 | 理工科系或工業工程管理相關科系大四學生  對半導體封測產業有興趣者 | | ■是  □否 |
| 工作內容及特性 | 1. 工作無危險性、若生產線有加班需求則需要配合。 2. 須穿著全套無塵衣，因工作特性需久坐或久站。 3. 日班07:20~19:20；夜班19:20~07:20，固定班別，做四休二或作三休三。 | | | | |
| 薪資 | 日班:月薪2,9600元。(做4休2) 、月薪2,3200元。(做3休3)  夜班:月薪3,7300元。(做4休2) 、月薪2,9600元。(做3休3) | | | | |
| 福利制度 | 1. 報到第一天即加保勞保、健保、團保，提供完整的工作保障。 2. 提供冷氣宿舍，二人一室每月1500元，前三個月免費(電費另計)。 3. 最高提供實習獎助學金40,000元。 4. 提供公司內部用餐補助、便利商店員工優惠折扣等福利。 5. 獎勵實習生勇敢踏入職場學習，提供獎助學金，並期勉同學能夠儘早取得就業入場券。 6. 鼓勵實習生優良表現，畢業後持續留用頎邦，年資續計並提供高額獎金給予嘉勉。 7. 實習屆滿前，舉辦內部徵選會，協助職涯發展與提供內部轉任機會。 | | | | |